

導電性をデザインするプラスチック

当社独自の配合・分散加工技術で、樹脂特性を損なうことなく、自由に導電性と良成型性を同時に実現する樹脂・エラストマーコンパウンドを開発します。

高導電(金属代替)～帯電防止まで幅広い導電領域の用途へ適用が可能です。

体積固有抵抗率(Ω・cm)

10⁻¹ 10⁰ 10¹ 10² 10³ 10⁴ 10⁵ 10⁶ 10⁷ 10⁸ 10⁹ 10¹⁰ 10¹¹

高導電

導電

半導電

帯電防止

特長・物性データ

01 薄くもできる

■ インフレーション成型による評価



PP樹脂フィルム成型品 / 50μmT

■ インフレーション成型フィルム(PP樹脂)の導電性

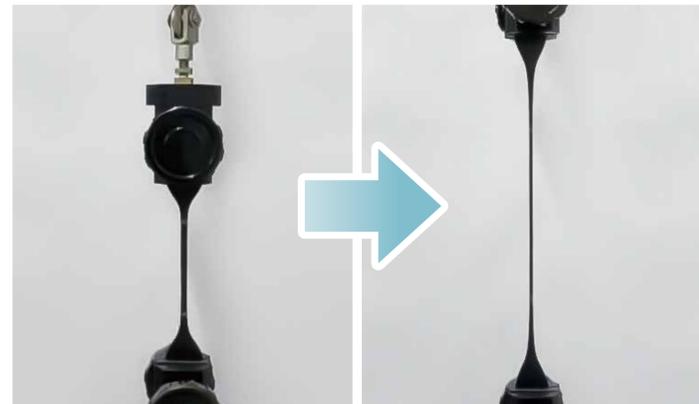
		100μmT	50μmT
体積抵抗率	Ω・cm	3×10 ¹	2×10 ²
MFR	g/10min	2.5	2.5

■ Tダイ 成型フィルム(PC樹脂)の導電性

		100μmT	30μmT
体積抵抗率	Ω・cm	5×10 ⁰	8×10 ¹
MFR	g/10min	3.0	3.0

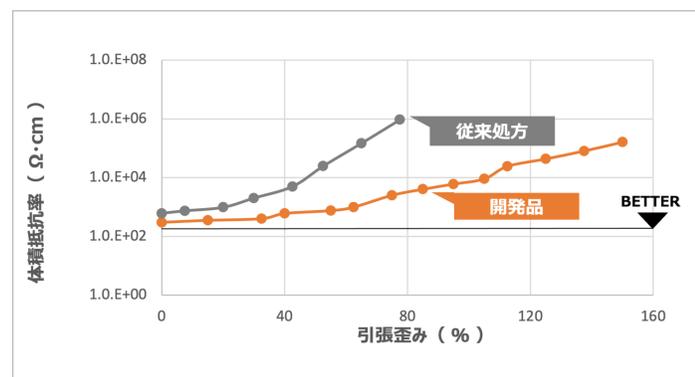
02 伸縮もできる

■ 引張試験機による評価



従来処方

開発品



03 樹脂本来の物性を維持

	ナチュラル	従来処方	開発品
導電性	-	1×10 ⁰⁻¹	1×10 ⁰⁻¹
衝撃強度	◎	×	○
引張伸び	◎	×	○
流動性	◎	×	○

フィラー・添加剤、分散方法の最適化により、分散後の樹脂物性の低下を考慮した設計です。

※本資料の物性データは特定条件下における当社評価結果であり、保証値ではありません。

適用用途

▼ 高導電～金属代替領域

- ・ヒーター、面発熱体
- ・センサー部材(電極)
- ・電磁波シールド部材(電子機器・通信機器など)

▼ 帯電防止～導電領域

- ・ESDシート(キャリアテープなど)
- ・搬送トレイ(半導体輸送容器)
- ・ウエハーキャリア
- ・輸送チューブ